



现在位置：[首页](#) > [新闻动态](#) > [综合新闻](#)

## 新闻动态

- ▶ [图片新闻](#)
- ▶ [头条新闻](#)
- ▶ [综合新闻](#)
- ▶ [学术活动](#)
- ▶ [科研动态](#)
- ▶ [通知公告](#)
- ▶ [业内信息](#)
- ▶ [合作交流](#)
- ▶ [科研项目资金管理](#)

## 集成电路检测及测试技术与未来发展国际高峰论坛在京举行

2017-06-08 | 编辑： | [【大】](#) [【中】](#) [【小】](#) [【打印】](#) [【关闭】](#)

2017年6月3日，集成电路检测及测试技术与未来发展国际高峰论坛在北京举行。此次高峰论坛由集成电路测试仪器与装备产业技术创新联盟主办、集成电路产业技术创新战略联盟、中国半导体行业协会和国家集成电路产业投资基金支持，中国科学院微电子研究所承办。科技部原副部长曹健林、国家外国专家局原局长马俊如、中国科学院微电子研究所所长叶甜春、国家02专项实施管理办公室副主任邱钢、科技部高新司技术发展及产业化司处长曹学军、国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武、中国半导体行业协会执行副理事长徐小田、华芯投资管理有限责任公司总裁路军以及联盟成员单位代表、有关专家、企业家出席本次论坛。

曹健林代表集成电路产业技术创新战略联盟理事长向参加论坛的各位领导和嘉宾表示热烈欢迎，并作了重要讲话。他指出，随着国家重大科技专项和国家集成电路产业投资基金的投入，我国在集成电路制造工艺、装备、封测和材料等各方面已经涌现出了一批具有标志性意义的重大科技成果，但集成电路整体水平与国际先进水平比起来还相对较弱，尤其在集成电路检测及测试技术领域较为欠缺。此次国际高峰论坛的顺利召开，将对进一步促进国内外集成电路检测及测试技术领域的交流与合作、推进集成电路领域产业链上下游的深度合作具有深刻意义。徐小田和丁文武分别致欢迎词并作讲话，预祝此次论坛圆满成功。

叶甜春代表集成电路测试仪器与装备产业技术创新联盟理事长和微电子研究所所长向莅临论坛的各位领导和嘉宾、理事单位及代表表示热烈欢迎并作主旨报告。报告围绕集成电路后摩尔时代的创新机遇和挑战，重点介绍了集成电路产业发展的若干热点、集成电路技术发展面临的挑战和集成电路测试产业现状与思考。

此次高峰论坛是集成电路测试行业国内首次峰会，以“开放、融合、创新”为主题，邀请了展讯通讯（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、长江存储科技有限责任公司、通富微电子股份有限公司、中电集团第四十一研究所、中科飞测有限公司、爱德万测试集团（Advantest）以及泰瑞达（Teradyne）等一批国际、国内知名企业的管理者和学者代表，分别在光学检测、电性测试及电子束检测三个方面进行了主题报告，深入研讨了集成电路检测及测试技术对产业关键技术、产业化标准和未来产业发展的影响，聚焦持续、合作、共赢的产业发展环境建设。

邱钢在最后的讲话中对此次高峰论坛给予了高度评价，认为此次论坛促成了联盟内外和国内国际创新资源及力量的技术交流，对促进集成电路产业链各环节深度合作起到了积极的推动作用。希望集成电路产业技术创新战略联盟及其成员单位能够进一步发挥桥梁和纽带作用，为我国“十三五”电子与信息领域重大专项顺利实施及后续集成电路的协同创新提供支撑，为我国及全球集成电路产业技术创新和发展做出新的贡献。



会议现场



曹健林致辞



马俊如讲话



徐小田致辞



丁文武致辞



邱钢讲话



叶甜春作主旨报告



爱德万测试集团 (Advantest) 市场和业务拓展副总裁三桥靖夫作主题报告



泰瑞达 (Teradyne) 中国区总经理晏斌作主题报告

